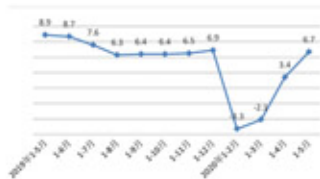


西安：1-5月规模以上工业增加值增长6.7%，集成电路芯片产量增长



西安市统计局发布的最新数据显示，2020年1-5月西安市规模以上工业增加值增长6.7%。
1-5月。全市规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.7%，较1-4月提高3.3个百分点。

分行业看，西安市36个大类行业中，7个行业总产值实现正增长，29个行业总产值同比下降。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长44.2%，电气机械和器材制造业增长7.4%，电力、热力生产和供应业增长2.1%。

分产品看，重点监测的24种产品中13种产品产量同比增长，11种同比下降。其中，智能手机增长74.3%，多晶硅增长69.5%，3D打印设备增长66.7%，单晶硅增长58.5%，移动通信基站设备增长36.9%，集成电路芯片增长13.1%，电子元件增长1.0%；新能源汽车下降66.2%。

来源：西安市统计局

前4月陕西对东盟进出口同比增长68.4%

记者5月22日从西安海关获悉：1月至4月，陕西进出口总值1185亿元，同比增长3.3%，增速在全国排名第7位，高出全国整体增速8.2个百分点。其中，陕西对东盟进出口135.9亿元，同比增长68.4%，高出全国进出口增速65.1个百分点，高出我国对东盟进出口增速62.7个百分点。

前4月，我省对东盟加工贸易进出口72亿元，同比增长65.5%；一般贸易进出口33.5亿元，同比增长20.9%；海关特殊监管区域进出口20.5亿元，同比增长38.8%。东盟地区主要国家中，我省对新加坡进出口66.4亿元，同比增长1.6倍；对马来西亚进出口9.5亿元，同比增长56.3%；对印度尼西亚进出口8.2亿元，同比增长2.5倍。主要出口产品中，我省对东盟机电产品出口85.9亿元，同比增长45.7%；农产品出口1.1亿元，同比增长57.5%；矿出口0.6亿元，同比增长1.3倍。

据业内人士分析，集成电路、能源经贸合作拉动我省与东盟贸易迅猛增长。集成电路是我省主要进出口商品。作为全球半导体产业链的一部分，我省与新加坡等东盟国家集成电路进出口贸易日趋紧密。前4月，我省对东盟集成电路进出口51.8亿元，同比增长32.2%，占我省对东盟进出口总值的38.1%。同时，东盟也是全球能源矿产类主要大宗商品生产地。前4月我省自东盟进口煤炭5.2亿元，拉动我省对东盟贸易增长6.4个百分点。中国—东盟自贸区升级带动相关产品进出口大幅增长。前4月我省对东盟出口农产品2.2亿元，同比增长75.5%。

此外，前4月我省对“一带一路”沿线国家进出口总值203.3亿元，同比增长36.8%，占全省进出口总值的17.2%，占比较去年同期提升4.3个百分点，增速高出全国进出口增速33.5个百分点。

来源：新华网客户端

胡和平刘国中会见三星电子副会长李在镕

5月18日，省委书记胡和平、省长刘国中在西安会见了三星电子副会长李在镕。

胡和平、刘国中对李在镕一行来陕访问表示欢迎。胡和平说，在陕西抗击新冠肺炎疫情初期，三星以仁爱之心向我们提供防疫物资帮助，陕西人民深表感谢。当前，陕西疫情防控取得阶段性重要成果，经济社会秩序加快恢复，包括三星在内的外资企业保持良好运行态势。我们将认真落实习近平总书记主席同志在离陕时达成的两国疫情联防联控、引领中韩关系迈上更高水平达成的重要共识，全面落实习近平总书记来陕考察提出的打造内陆改革开放高地要求，进一步加大对投资企业复工复产的支持力度，帮助解决物流流通、人员往来等方面问题，为企业在疫情防控常态化条件下生产经营创造良好环境。我们愿与三星增进友谊、深化合作，全力服务和保障三星在陕项目建设，进一步加强闪存芯片、逻辑芯片、动力电池、生物医药等领域的合作，推动双方共同发展、互利共赢。

李在镕对我省在疫情防控中给予三星的支持和帮助表示感谢。他表示，三星在陕项目进展顺利、效益良好，愿继续拓展合作领域、深化交流交往，为谱写陕西新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

省委常委王浩、卢建军，西安市市长李明远一同会见。

来源：陕西日报



华为中国区运营商总部落户西安

据媒体报道，2020年1月，陕西省政府工作报告中曾透露，2019年华为中国区运营商总部项目已经落户陕西。只是时受春节和疫情影响，外界忽略了这一重大消息。在内部进行公示。华为中国区运营商总部落户西安，首先为西安近年来大力打造的总部经济再添一员猛将，为区域经济发展带来诸多外溢效应，比如税收效应、产业集聚效应、产业关联效应、消费带动效应、就业乘数效应、资本放大效应等明显的外溢效应。

自2008年华为西安研究所正式设立后，目前华为西安研究所员工总数近20000人，已形成了FBB固定网络、MOB移动网络、云计算、终端四大业务领域。在华为全球16个研发中心中是员工数量最多、业务布局最全的研发中心，其研发的产品销售收入已占华为整个销售收入30%以上。

2017年，华为公司与陕西省政府战略合作协议签约仪式，决定落地华为西安研发基地二期项目。华为西安研发基地二期项目是华为全球技术支持中心新基地，是华为除总部外最大的研发基地。

来源：集微网

华为鲲鹏产业生态产学研对接会暨西安电子信息产业创新联盟揭牌仪式举行



为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，促进科技、金融、产业、人才有机结合，推动全市经济高质量发展。5月21日下午，由市科技局和高新区管委会主办的“华为鲲鹏产业生态产学研对接会暨西安电子信息产业创新联盟揭牌仪式”成功举办。

副市长马海萍出席会议并讲话，市政府副秘书长杨国社，华为公司西安政企业务总经理袁超、陕西计算机务部部长王伟以及市工信局、市大数据局、高新区管委会

会相关负责同志，西安驻市高校院所专家及60余家高新技术企业负责人参会，市科技局局长李志军主持会议。

会议听取了华为公司发展战略、鲲鹏生态与合作需求、鲲鹏生态合作企业发展情况等介绍。来自西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学等驻市高校的创新团队围绕各自学科专业特点等推介了创新成果；紫光国芯、奥卡云数据、星展测控等鲲鹏生态产业上下游企业代表作了交流发言。会上还举行了西安电子信息产业联盟揭牌仪式。

会议综述

要着力构建“6+5+6+1”现代产业体系。打造支撑高质量发展的“四梁八柱”。以创新驱动引领高质量发展，加强科技创新，围绕创新链布局产业链，充分发挥高校和科研院所研发优势，搭建产学研用协同平台，推动科技成果就地转化。为实现产业化提供良好的产业平台和承载。形成科研创新与产业发展的良好互动。

要重点集聚华为等龙头企业，以领先技术作为支撑点。扩大关联领域和上下游联系应用，形成一批创新链条，催生更多应用，促进成果与产业紧密对接。科技与经济紧密融合，提升西安产业核心竞争力。

要进一步处理好政府和市场的关系，有效发挥市场的决定性作用，牢固树立企业创新主体地位。为企业提供更加精准的五星优质服务。

西安将制定普惠性政策，助力更多企业搭上信息产业转型升级快车。实现更好的发展。打造西安电子信息产业创新创业生态体系。

据了解

西安与华为携手打造鲲鹏产业生态，将通过生态创新中心、行业联盟、产业联盟等多种运作机制，有效协同产业各方制定相应的发展策略，达成产业共识。构筑安全可靠产业发展新高地，助推省、市数字经济发展迈上新台阶。

来源：市科技局高新技术处

西安高新区：电子信息产业预计今年底实现产值2300亿元

6月12日，西安市加快建设先进制造业强市新闻发布会召开。会上，西安高新区介绍了电子信息产业集群发展情况。

据悉，1-4月，西安高新区电子信息产业实现产值630亿元。预计到2020年底实现产值2300亿元。电子信息产业总体发展势头良好，龙头企业抗风险能力持续增强。目前，高新区已形成以三星、美光、华为、中兴、中软国际等为核心的全产业链电子信息产业集群。

西安高新区正全力打造全球知名电子信息产业创新高地。三年内将统筹安排50亿元引导基金出资设立电子信息产业发展基金，同时每年安排不低于3亿元普惠政策资金重点支持电子信息领域重大科技成果转化。企业加大研发投入等方面，并且每年新增建设用地指标将优先向电子信息产业倾斜。

2019年年底，西安发布了《西安高新区电子信息产业集群行动方案》，重点围绕半导体、高端软件、智能终端、智能网络四大领域，打造“芯—软—端—网”为一体的电子信息产业集群。预计到2022年底，西安电子信息产业规模达到3000亿元以上，电子信息产业综合实力国内领先。到2025年，力争电子信息产业规模突破4500亿元，全面建成全球知名电子信息产业创新高地。

出自：壹集微

5亿元芯片封测生产线项目签约落户陕西铜川



5月17日，2020年陕西省重点招商引资项目云签约活动在线举办。47个重点项目利用网络平台成功签约。

此次成功签约的47个项目总投资1029.15亿元，涉及高端装备制造、电子信息、能源化工、商贸服务等多个领域。

其中，铜川此次签约的重点项目涉及基础设施配套、光电子、装备制造等产业领域，包括舞美耀华科技产业园项目与芯片封测生产线项目。

据悉，舞美耀华科技产业园项目由深圳市舞美泰和电子科技有限公司投资建设，拟投资20亿元。该项目拟建设占地约150亩的集单面、双面及多层柔性线路板、软硬结合电路板及电子元器件封装加工、电池模组、集成电路、模具、光机电一体化产品、LED照明器具、特种精密定制电源、太阳能及相关产品生产为一体的柔性线路板制造及贴片组装加工基地。项目分两期建设，建成后预计年产值将达到90—100亿元。

芯片封测生产线项目由深圳市鑫国汇投资管理有限公司投资建设，计划总投资5亿元。该项目分三期建设。一期芯片封装后测试（FT测试）；拟投资1亿元，100台套设备，产值约1亿元；二期封装前晶圆测试（CP测试）；拟投资1.2亿元，20套测试设备，产值约1亿元；三期芯片封装（全工艺）；拟投资1.5亿元，两条产线设备，产值约1.5亿元。

来源：集微网

政协委员郝跃：设立集成电路一级学科要纳入到国家统一评估体系

三星电子副会长李在镕视察西安半导体厂

据韩联社报道，三星电子副会长李在镕18日视察西安半导体工厂，在疫情下暂停4个月后将重启全球经营活动。

报道援引“三星电子”的消息，李在镕此次赴华到厂视察，讨论疫情蔓延对工厂的影响及对策，并慰问员工。在视察时，李在镕指出，善于过去或安于现状就没有未来，创造新的增长动力需要未雨绸缪迎接变化，时时无多，机不可失。“这番话体现了三星在新冠疫情、讼案等重锤利空扎堆之际，迈大步从从容容不待迟疑的迫切危机感。”



报道称，李在镕6日对全体员工宣布告别新冠，缔造新三星后，扩大国内外经营活动范围。

13日，李在镕与现代汽车集团首席执行官郑义宣讨论新一代动力电池业务，没过几天又决定在疫情下访华。

去年4月，三星确立目标：到2030年成为系统半导体产业领头羊。报道认为，李在镕疫情期间出访第一站选择西安，旨在强调实现半导体发展蓝图“半导体愿景2030”的决心。

西安工厂是三星在海外唯一的半导体存储器生产基地，疫情下三星仍然如期扩建半导体二厂。三星在西安建设的生产线也是当时世界上最先进的半导体生产线之一，代表着半导体行业最尖端的科技水平。

据悉，三星电子一期投资108亿美元，建成了三星电子存储芯片项目和封装测试项目；二期项目总投资150亿美元，主要制造闪存芯片。2019年12月10日，三星电子闪存芯片项目二期第二阶段80亿美元投资正式启动。其中，第一阶段投资约70亿美元，2020年3月竣工投产；第二阶段投资80亿美元，2021年下半年竣工。二期项目建成后新增产能每月13万片，新增产值300亿元，解决上千人就业，并带动一批配套电子信息企业落户，使西安成为全球水平最高、规模最大的闪存芯片制造基地。

去年2月春节期间，李在镕也曾访问西安。今年1月春节假期，李在镕访问巴西，视察坐落玛瑙斯工厂。

韩联社还指出，在疫情下，李在镕此行得益于韩中两国政府本月起建立重要商务人员往来的快速通道，对新冠病毒检测呈阳性的企业家隔离14天的措施。

来源：观察家网



2019年，复旦大学宣布“集成电路科学与工程”博士学位授权一级学科将于2020年试点建设，并启动博士研究生招生。集成电路一级学科的设置，对于实现集成电路知识的体系化、系统化，加强集成电路技术的创新发展和创新人才培养具有重要意义。

全国政协委员、中国科学院院士郝跃在接受《中国电子报》记者采访时表示，设立集成电路一级学科要纳入到国家统一的评估体系中去，在国家学科建设与管理的框架下面进行探讨。在学科建设上，要并置基础课程和实践环节，实现人才培养的同时，我国集成电路的发展仍需提升产业核心竞争力，加速关键技术和产品突围。郝跃建议，我国集成电路要强化自身发展和持续创新的动力，并提升科研成果转化能力，将技术落实到产品上。

集成电路人才培养要强化实践环节。集成电路产业的发展壮大要靠高素质人才，人才是产业创新的第一要素。《中国集成电路产业人才白皮书（2018-2019年版）》数据显示，截至2018年年底，我国集成电路产业从业人员规模约为46.1万人，从业人员总量比2017年同期增加了6.1万人，增长率15.3%。但是，从总体上看，我国集成电路人才依然存在较大缺口。预计到2021年前后，全行业人才需求规模为72.2万人左右。这意味着，至2021年，我国仍然存在26.1万人的集成电路人才缺口。设立集成电路一级学科，对于加速学科发展，促进

集成电路领域人才的高质量培养具有重要作用。

郝跃指出，复旦大学设立“集成电路科学与工程”一级学科是很有意义的举措，要促进我国集成电路人才数量和质量的快速提升，要设立集成电路一级学科纳入到国家统一的评估体系中去，在国家学科建设与管理的框架下面进行探讨。同时，对于集成电路一级学科如何划分，如何合理融入现有的教育体系，要在结合实际的情况下广泛参考各国集成电路人才培养的经验教训，体系化、高质量地培养集成电路人才。

郝跃表示，当前集成电路的人才培养有两个方面需要加强。一是基础性课程的体系建设。尤其要保证微电子、物理、数学等基础性、主干性课程学时充足、内容合理，能够系统地向学生讲授；二是加强课程的实践性，并通过建设人才培养基地等集成电路人平台，将校、企等各方力量动员起来。

“集成电路本质上是与科学实验、工程实验紧密结合，实践性很强的学科，必须强化实践环节。如果让集成电路设计专业的学生有机会在本科或研究生时期参与流片，将有助于提升学生的认知水平，实现从感性到理性的提升。”郝跃说。

集成电路突围要强化能力和产品。近年来，我国集成电路产业发展取得了长足进步，但是核心技术受制于人的局面仍然没有根本改变，急需加强核心技术攻关，提升产业竞争能力。对于如何加强集成电路产业的突围能力，郝跃提出了两点建议。

首先是产学研紧密结合。加大对关键核心技术的攻关和产业化，建立集成电路自身发展和持续创新的机制。

“我们现在对产品、技术强调的多，对‘能力’强调的少。所谓能力，是自身发展的能力、不断创新的动力。有了这项能力，集成电路产业能够持续、整体地发展，而不是‘头疼医头，脚疼医脚’。”郝跃表示，“要发展和创新能力的培养，要靠‘产学研’的紧密结合。”

其次是科研成果要落实到产品上。推动产业从不可用走向可用，进而走向耐用、好用、耐用、实用。

“要将技术落实到产品上，将产品落实到能力上。我们的集成电路产业才能真正‘长大’。”郝跃说。

来源：中国电子报

西电与紫光集团有限公司签订全面战略合作协议



6月21日下午，紫光集团有限公司考察团来西电，双方围绕协同创新、人才培养、区域发展等方面进行交流研讨，建立全面战略合作伙伴关系。座谈会在校区科技楼报告厅举行，紫光集团董事长兼首席执行官赵伟国，联席总裁刁石京，联席总裁、新华三集团首席执行官关海，联席总裁王慧科，学校党委书记董登友，校长杨宗凯参加会议，会议由党委书记杨俊堂主持。座谈会前，郝联生

会见了紫光集团有限公司考察团一行。

杨宗凯在致辞中代表学校对紫光集团有限公司考察团的到来表示热烈欢迎，对紫光集团助力西电教育事业表示感谢。他表示，西电是一所“双一流”大学，电子信息学科优势明显，紫光集团是全球集成电路和移动互联网领域领先的龙头企业，致力于成为世界级“从芯到云”的高科技产业集团。双方有着共同的发展理念和良好的合作基础。希望通过此次签订全面战略合作协议，加强彼此在半导体集成电路、人工智能、云计算等方面的交流合作，在协同创新、人才培养和区域发展等领域互相支持，实现产教融合、合作共赢。

赵伟国介绍了紫光集团有限公司的发展历史。他表示，西电人才济济，此次签订全面战略合作协议对双方之间的合作是有重要意义的，紫光集团会全力支持与西电的合作，希望双方在就业方面加强交流合作，未来我们会在西电举行校园招聘。紫光集团可以成为未来西电学生的就业选择；希望双方在半导体集成电路等领域的科技创新和成果转化方面进行深入交流，结合人工智能，优势互补，共同发展。

董登友在讲话中向紫光集团长期以来对西电发展的关心支持表示感谢。他表示，紫光集团是我国半导体实现赶超的重要战略平台，承担国家重大科技计划项目任务；西电在电子信息领域有鲜明的学科特色与优势，善于担当、敢于担当、执行力强。他强调，此次双方抓住重要合作契机，强强联手，签订全面战略合作协议，将推动产学研深度融合，产出高水平科研成果，为落实国家重大战略任务贡献力量。

与会人员就集成电路、人工智能、云与大数据、智慧教育等领域，围绕协同创新、人才培养、区域发展等方面进行交流讨论。

座谈会上，双方代表签订了全面战略合作协议和紫光集团捐赠协议。会后，考察团参观了人工智能学院和宽禁带半导体材料教育部重点实验室。

来源：西安电子科技大学

年底前开工建设，13亿元上海博康光刻设备及光刻材料项目落地西安

据西安晚报报道，上海博康光刻设备及光刻材料项目总占地200亩，总投资13亿元，满产后产值20亿元以上，年贡献税收1亿元以上。

博康落户高陵，既填补了全市半导体光刻领域产业的空白，也将吸引电子信息产业集聚，拉伸先进制造业链条，为西安产业动能转换和经济结构优化升级做出积极贡献。

资料显示，博康集团成立于2016年，注册资本1亿元，主要从事化工科技、生物科技、材料科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光刻材料、半导体新型材料的研发及销售，化学试剂（除医疗、诊断试剂）、化工原料及产品（除危险化学品）、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料、橡胶制品、塑料制品、机电设备、集成电路软件、实验室设备的销售，集成电路生产设备研发、设计、制造及售后服务等业务。

据悉，为确保项目顺利落地，高陵区将严格落实重点项目包抓责任制，成立由区委书记、区长牵头的服务保障专班，对项目落地和建设过程中不重视不积极、工作措施不力、进展缓慢甚至迟迟没有进展的，高陵区委区政府将实行重点督办和约谈问责，确保项目年底前开工建设，早日投产达效。

来源：集邦半导体观察



西安三星存储芯片二期项目第一阶段预计今年Q3实现满产

据新华社报道，三星（中国）半导体有限公司一季度进出口额为278.67亿元，相较去年同期增加45%。二期项目第一阶段预计在今年第三季度实现满产。

三星（中国）半导体有限公司副总裁池贤基表示，疫情期间，三星半导体存储芯片二期项目第一阶段正处于设备调试期。为了确保产品顺利下线，西安高新区建立了重大外资项目专班机制，通过包机帮助三星接回700多名工程师，还从湖北帮忙运回了关键原材料。

三星存储芯片项目2012年落户西安高新区。一期项目2014年5月竣工投产，总投资108亿美元，建成了三星电子存储芯片项目和封装测试项目；二期项目总投资150亿美元，主要制造闪存芯片。

其中，二期项目第一阶段投资的70亿美元；第二阶段投资80亿美元，预计2021年下半年竣工。二期项目建成后新增产能每月13万片。

2017年8月30日，三星电子株式会社与陕西省政府签署了投资合作协议，决定在西安高新综合保税区区内建设三星（中国）半导体有限公司存储芯片二期项目。

2019年12月10日，三星电子闪存芯片项目二期第二阶段80亿美元投资正式启动。

2019年12月25日，西安三星12英寸闪存芯片二期第二阶段项目正式启动。

来源：集微网



携手共建 共同促进郑州航空港实验区集成电路产业升级

为进一步完善产业链条、加快打造以智能终端为代表的电子信息产业集群，6月10日上午，郑州航空港实验区管委会、中国航天科技集团第九研究院第七一研究所（简称“七一一所”）、达维多企业管理有限公司在西安签订战略合作协议。

根据协议，三方拟合作建设半导体生产制造及封装基地项目。该项目将在航空港实验区建设第三代化合物半导体SiC生产线、高可靠集成电路封装生产线、工业模块电源生产线，打造集成电路设计、芯片制造、先进封装为一体的产业生态体系。这是航空港实验区在集成电路领域继单晶硅片、先进靶材、晶圆先进切割设备等项目的基础上又一重大突破。标志着实验区集成电路产业实现全产业链布局，产业生态逐步形成。航空港实验区管委会副主任魏学彬与中国航天科技集团第九研究院第七一研究所所长唐磊、达维多企业管理有限公司董事长王彬等举行座谈并见证签约。

目前郑州航空港实验区正在大力打造以智能终端为代表的电子信息产业集群。集成电路产业链作为电子信息产业的上游，具有极强的辐射力、带动力。郑州航空港实验区将积极创造条件，营造良好环境，为项目发展壮大提供优质高效服务。

中国航天科技集团公司第九研究院第七一研究所，始建于1965年10月，主要从事计算机、半导体集成电路、混合集成三大专业的研制开发、配套、检测经营，是国家唯一集计算机、半导体集成电路和混合集成科研生产为一体的大型专业研究所，全球1700多个“中兴通讯”的创办单位，是我国航天微电子和计算机的先驱和主力军。

出自：郑州航空港实验区发布



投产可期？西安奕斯伟百亿项目首批样品已产出

6月29日，西安市发改委负责人在第十六届人大常委会第三十四次会议上，作了西安市2020年1—6月份市重点项目建设进展情况报告。报告指出，西安奕斯伟硅产业基地项目首批样品已产出。

据亦城时报6月报道，西安奕斯伟单晶硅片生产线投产已进入倒计时。目前来看，西安奕斯伟产业基地项目进展顺利。

2017年12月9日，北京奕斯伟公司与西安高新区、北京芯动能公司三方共同签署了硅产业基地项目投资合作意向书。

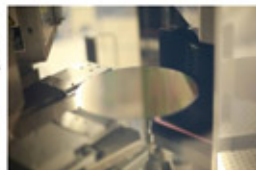
根据意向书，该项目总投资超过100亿元。项目建成后将成为研发生产300mm（12英寸）硅片，建设月产能50万片、年产值约45亿元的生产基地。最终目标成为月产能100万片、年产值超百亿元的12英寸硅材料企业。

2019年1月，西安奕斯伟硅产业基地项目正式封顶。据陕西日报2月份报道，陕西省集成电路基金向西安奕斯伟项目累计投资27亿元。项目厂建设已进入竣工验收阶段。

北京奕斯伟科技集团有限公司是一家半导体领域产品和服务提供商。核心业务涵盖芯片与方案、硅材料、先进封装三大领域。硅材料业务主要包括12英寸全球先进制程硅单晶抛光片和硅片；先进封装业务主要包括芯片后端封装、COF封装、面板级集成封装三类业务。

据悉，目前，除西安外，奕斯伟在合肥、海宁等地也有所布局。2019年6月，奕斯伟集成电路设计研发基地签约落户海宁。2019年12月，合肥奕斯伟COF封装项目量产。

来源：壹集微



商汤科技西安研究院投资协议签订，将在陕西西咸新区投建西安研究院项目



6月29日，陕西西咸新区和商汤科技签订《商汤科技西安研究院投资协议》。

根据协议，商汤科技将在西咸新区投资建设“商汤科技西安研究院”项目，建设500人规模的人工智能算法研究院和西北最大的人工智能综合体验中心，与院所共建4座联合实验室，构筑人工智能产业生态圈。

据西安发布报道，商汤科技联合创始人、首席执行官徐立表示，商汤科技将把最新最精最尖端的技术布局在西安先行

先试，深耕前沿课题研究，深化智慧城市领域合作，助力西安人工智能产业发展。

此外，陕西省委常委、西安市委书记王浩表示，商汤科技是全球领先的人工智能平台公司，商汤科技西安研究院项目的落户将有力推动国家新一代人工智能创新发展试验区建设。

来源：壹集微

SEMICON 2020顺利开幕 上海市副市长吴清到场祝贺

作为SEMICON China半导体年度盛会中最不容错过的内容，开幕主题演讲（Grand Opening）于6月27日正式拉开帷幕。Grand Opening汇集了全球顶级行业领袖，分享全球业界领袖智慧和视野，是了解全球产业格局、前沿技术与市场走势的好机会。



SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙

SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在致辞中表示，今年是特别的一年，他认为今年有三个特色。其一是坚持，曲曲折折，排除万难。从1月国内、3月国外疫情爆发，国家实施签证管制。直到5月8号中疾控中心和上海市政策放松，5月13日正式批准，“可谓过关难过”。其二是坚持，不容易。在此我代表SEMI特别感谢各级领导，包括上海市政府、经信委、商委、浦东会展办、中国电子商会、参展商、产业大佬、演讲嘉宾，及广大观众支持。因为你们的支持，这个会才能够如期举办。当然我要感谢SEMI、中国电子商会、Sands团队过去半年的付出及努力。”

特别之二是SEMICONFPD China作为今年电子半导体行业首展，复工复产，稳步前行，这是今年以来第一场大型的专业活动。“这是上海大型专业展会的首展，象征上海及中国在疫情的同时，经济复苏，稳步前行。这也是中国电子半导体产业2020年的首展。”

第三个特点我认为这是一个指标。这次SEMICON China的举办也可以象征中国半导体产业复苏的一个重要指标。由于5G、新基建、智能应用，中国半导体市场的需求将带动全球产业的复苏。居龙表示，受疫情影响，此次展会面积达8万平米，有900多家展商大约3200个展位，展商涵盖芯片设计、制造、封测、设备、材料供应商等半导体全产业链，展会同期还有20多场论坛演讲。”



SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha

SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha在云致辞中表示，SEMICONFPD China 2020的举办对于整个电子设计、电子生产企业来讲是一个令人振奋的里程碑，有望给以后会议树立大会标准。

“在半导体行业2020年将会去向何方，我们首先预期行业会有前所未有的增长，但是现在我们面临前所未有的挑战。除了疫情爆发的原因，全球经济危机、地缘政治、贸易摩擦以及一些全新的控制和监管，导致不少业务停摆。”尽管如此，SEMI依旧支持整个行业，展示行业当中坚不屈的精神，帮助行业迎难而上。此外，SEMI正在积极地做游说工作，与政府进行沟通，以保证行业当前最根本的经济基石，为行业创造价值。



上海市委常委、副市长吴清

上海市委常委、副市长吴清为开幕主题演讲致辞。今年是为特殊的一年，我们正面临许多挑战，但是对未来充满信心。在很多新兴领域里面，在线新经济、互联网新生态企业的发展都取得了长足的进展。“这也就是所谓的危机。同时这些也都向世界再次展示了上海依然是块投资沃土，创新的高地，创业的舞台。上海长期集聚的开放优势、人才优势、产业优势，非常重要不可替代。”

“我们共同推进全球半导体产业的发展。我相信科技是没有国界的，产业也应该是没有国界的。我们通过世界的努力所共同推进产品、服务、以及产业的创新发展，它服务于全人类，将推进人类福祉的进步，将更好地维护我们共同的地球家园。”



SEMI董事会主席、应特格德电子总裁兼首席执行官 Bertrand Loy

SEMI董事会主席、应特格德电子总裁兼首席执行官 Bertrand Loy表示，作为全球半导体重要协会，SEMI代表各个国家地区以及全球半导体产业的多元化视角和观点。SEMI董事会的全球化思维，探寻行业机会、趋势、挑战，为产业界提供真知灼见。为上下游发展。SEMICON会议提供了全球复工复产的信息，为行业找到商业机会。疫情之下，AI、5G、量子计算的热度依旧没有消失，经济数字化仍在加速。整个半导体行业，拥有令人振奋的增长机会。



中国电子商会会长王宁
中国电子商会会长王宁为大会致辞。SEMICONFPD China 2020展览会今天在上海隆重开幕。

半导体和集成电路产业是我国非常重视的行业之一，是数字经济和未来科技发展的重要技术行业。“不过我个人认为半导体和集成电路行业中国与世界还存在着两大差距。”王宁指出，第一个是供给和需求之间的差距；第二个是在半导体制造技术上，我国和世界先进国家的水平还有很大的差距，尤其是在半导体材料、制造设备方面，对此，中国政府也一直非常重视行业的发展，积极采取各方面的支持政策。

虽然差距仍然存在，但我国近年来的半导体制造业在飞速发展。王宁特别希望每年的SEMICON China能够举办，为我国半导体行业尤其是半导体制造技术提供巨大帮助。



中国工业和信息化部副部长、中国工业经济联合会会长李毅中

中国工业和信息化部副部长、中国工业经济联合会会长李毅中提出，从半导体设备、半导体材料以及集成电路产业链各环节、结构来看，我国集成电路产业已有一定基础，但存在较大差距。对于疫后振兴发展集成电路产业，李毅中提出了几点思考：1）我国半导体市场广阔，对集成电路需求潜力大；2）聚焦关键技术，坚定本土芯片实现进口替代；3）加大投资、合理布局，加快半导体产业发展；4）冷静应对外资撤离，坚持扩大开放。



中国半导体行业协会理事长周子学

中国半导体行业协会理事长周子华作了嘉宾主题致辞，他说，中国集成电路上半年形势逆势上扬，背后说明行业特殊性，不会跟旅游业、餐饮业一样，因为交通中断而受到毁灭性打击。在疫情中，所用的电子信息产品，许多是增加的，尤其是网络产品。提到产业链商业，软就是软件，硬的部分都是集成电路。抗疫过程中，许多领域的集成电路应用是增长的。半导体是高度国际化产业，没有一个国家可以关门发展。



长存存储联盟首席技术官程卫华
长存存储联盟首席技术官程卫华带来了《探索内存发展可能，共同迎接未来挑战》主题演讲。2020年是个不平凡的一年，这一年经历了新冠疫情的全球蔓延，国际局势的变幻莫测。全球产业链受到了极大的冲击。同时疫情给人们的生活方式和半导体技术带来了改变。消费市场的需求带动了SSD的需求，以及云上业务驱动企业级SSD需求增长。从全球市场综合发展来看，企业级SSD、电脑、智能手机将驱动SSD市场不断增长，预计到2024年，SSD的需求会占据内存总量的57.7%，智能手机存储的需求占到27%。程卫华解读了长存存储3D NAND技术与解决方案产品的市场动态，并探讨了疫情后全球NAND内存技术与市场的发展趋势。



紫光展锐首席执行官董庆
紫光展锐首席执行官董庆的主题演讲围绕《高科技企业的管理》展开。他比喻童年时期的初创企业就像哪吒，拥有三昧真火（原始能量），包括重要的原创技术、社会资源关系，且创业团队要求没有私心杂念。当企业不断成熟则需要处理更多社会关系，此后更要注重流程的重要性。董庆表示，流程是贯通高科技企业的血管，其作为运作的知识非常关键。同时创新是绕不开的课题，离开创新高科技企业就不存在。所有的创新来源于破除、释放资源，将资源在新框架中重组。创新是挺进无人区，首先是方向的质疑和探索。“战略和创新的统一是高科技企业最重要的特征。”引用英特尔创始人格鲁夫的一句话：“这是一个10倍速发展的行业，只有偏执狂才能成功。”创新已是不得不做的事情，在企业成长的狂风中，我们还要依靠企业家精神不断拓展未来。



格芯高级副总裁及亚洲业务发展负责人Americo Lemos

格芯高级副总裁及亚洲业务发展负责人Americo Lemos分享了《风与雨中成长：新常态下的半导体业务》。他指出，如果行业和公司想要在新世代茁壮成长，就要思考经营之道，以便应对已经出现的挑战。如今，我们不能再依靠持续自由和开放的商品贸易，必须让企业在更分散的世界中运营做准备。其次，我们不能再依靠自由和开放的技术跨境流动，因为知识产权与许可技术日益受限。不过，新应用的驱动，如人工智能、5G、物联网、自动驾驶使得产业发生革命性变化。为行业创新打开了大门。而为了促进行业创新，晶圆业务是真正的关键环节，促使创新成果能更快、更经济、更顺利地推向市场。

来源：SEMI中国

半导体封装：5G新基建催生新需求

封装是半导体生产流程中的重要一环，也是半导体行业中，中国与全球差距最小的一环。然而，新冠肺炎疫情的突袭，让中国封装产业受到了一些影响。但是，随着国内数字化、智能化浪潮的不断推进，中国的封装产业增加了更多冲抵疫情阴霾、拓展原有优势取得进一步发展的机会。

产业上受影响较大
根据华天科技（昆山）电子有限公司董事及总经理肖智斌的介绍，封装产业的上下游供应链共分为四大方面：IC设计、晶圆制造、半导体材料以及半导体设备。此次新冠肺炎疫情的突袭，不仅给我国封装产业整体发展带来了影响，同时也给产业上下游带来了冲击。

封装产业链上下游均受到了或大或小的冲击。有些影响短期看来甚至“较为严重”。“短期来看，封装终端市场需求面临萎缩，摩根大通和ICD均预测2020年全球半导体市场将下滑6%。尽管国内疫情已经得到有效控制，封装产业也在逐步复工复产，但是随着海外疫情的爆发，终端需求急剧下降，对我国封装产业形成了不小的冲击。”肖智斌说。

抓住机遇转“危”为“机”
从短期影响来看，疫情确实对封装产业造成了很大影响，然而肖智斌认为，从长期影响来看，疫情的冲击给中国封装产业带来了更多机遇。“海外疫情的爆发造成许多国外封厂厂商工厂减产或关闭，境外订单向国内转移，国内大厂如果整合产能将供应链迁往国内，国内疫情逐渐得到控制，复工复产在有条不紊地进行，用工问题基本得到解决。因此如果国内封厂厂商能够抓住机遇，提升产品竞争力，有望重塑产业链，由封测产业的跟随者转变成产业领导者。”

同时，中国作为最大的芯片消耗国家，本身拥有庞大的封装市场空间。因此国内封装企业可以通过挖掘潜在的国内客户需求增加订单量，以此来弥补海外订单量的不足。“未来一段时间内，国内封装行业将更加依赖国内市场需求的持续增长。而当下中国正聚力数字化与信息化建设，5G等新基建的步伐也在越来越快，新的应用场景将不断催生更多的芯片封装需求。未来国内封装市场将不断增大，并将逐步抵消国外订单下降给封装行业带来的风险。”肖智斌说。

唐伟伟也认为，若能抓住机遇，封装产业也许可以将疫情带来的影响转“危”为“机”。“对于我国封装产业

来说，疫情是很大的挑战。但若能在此期间，抓住更多国际上生产订单的机会，在疫情结束后将会形成惯性。如今中国的封装产业基本上复工率在85%以上，很多工厂都采用了集中租人的模式来保证人力资源。因此我认为，若能抓住机遇，疫情对我国封装产业所造成的不利影响将会大大减少，甚至有望迎来更好的发展机遇。”他说。

同时，随着韩国、日本疫情的逐渐缓解，封装上游材料进口短缺的问题目前已经得到了有效解决。作为一个全球化布局的产业，半导体行业的发展离不开国家之间的合作。因此，若要推动封装产业的发展进步，单靠自身的力量肯定远远不够，必然需要依靠全球的力量。

5G+AI带来机遇
中国的5G进入了并轨式的发展，中国的封装产业能否借此机会，在海外高端产品市场站稳脚跟，成为了人们热议的话题。肖智斌认为，SiP（系统级封装）技术的发展便是我国封装企业很好的发展机会。为了满足5G的发展需求，晶圆制造厂提出了SoC（系统级芯片）解决方案。但是SoC高度依赖EUV极紫外光刻这样的昂贵设备，良率提升难度较大。为了满足多芯片互联、低功耗、低成本、小尺寸的需求，SiP应运而生。SiP封装技术集成度，将多种功能芯片，如处理器、存储器等集成在一个封装模块内，成本相较于SoC大幅度降低。另外，晶圆制造工艺已经来到7nm时代，后续还会往5nm、3nm挑战，但伴随而来的是工艺难度将急剧提升，芯片级系统集成的难度越来越大。SiP给芯片集成提供了一个既满足性能需求又能减少尺寸解决方案。

中国半导体行业协会副理事长于康康认为，未来我国封装产业若想大力发展，必须实现从高速发展向高质量发展转变。“封装中道”的崛起和先进封装技术的进步，是封装技术发展带来的创新机遇。高性能计算、高频、高速、高可靠、低延迟、微系统集成等需求推动了AIP、FC、2.5D/3D、Fan-out扇出型封装等先进封装技术的应用。这是5G+AI发展带来的机遇。

5G时代我国封装行业迎来了很多机遇，但也面临着一定的挑战。于康康认为目前需要解决的主要问题有四点：一是要进一步缩小先进封装技术差距；二是要进一步补齐产业链上的短板；三是要解决人才的引进和培养问题，做大做强封装企业；四是要解决先进封装平台的布局，实现封测产业协同发展。

来源：中国电子报

中国城市集成电路竞争力排名榜

中国大城市集成电路竞争力排名



芯思想日前发布中国城市集成电路竞争力排行榜。报告对中国大陆30座城市从产业规模、GDP规模、产业链支撑、市场需求、政策支持、创新能力等6个方面进行评估，每个单项最高分为5分，按照相关权重进行排名。

中国大陆城市集成电路竞争力排行榜前10强中，长三角地区占有五席，分别是上海、无锡、合肥、南京、苏州（其中江苏省有三支城市入选）；珠三角地区只有深圳一个城市入选；而环渤海也只有北京一个城市入选；中西部有三个城市入选，分别是成都、西安、武汉。

上海市提出推动集成电路全产业链自主创新，提升产业规模和能级，打造具有国际影响力的软件和集成电路产业集群和创新源，规划到2020年集成电路产业规模为2000亿元。根据上海集成电路行业协会的数据，2019年上海集成电路产业规模已超过1700亿元，其中设计业715亿元，制造业389亿元，封测业382亿元，设备材料业218亿元。上海在设计领域，部分企业研发能力已达7纳米，紫光展锐手机芯片市场占有率位居世界第三。在制造领域，中芯国际、华虹集团销售额在国内位居前两位，14纳米先进工艺已量产，在装备材料领域，中微、上海微电子国内领先水平，刻蚀机、光刻机等高端产品已达到接近国际先进水平。上海集成电路产业投资资金总额500亿元。分为100亿元的装备材料基金、100亿元的设计基金、300亿元的制造基金。基金将加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI存储芯片、安全芯片以及智能存储芯片等高端芯片的研发和生产。

北京市规划到2020年建成具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地，集成电路产业发展目标虽然没有提出具体的数字，但北京集成电路产业近年来获得长足发展，产业

自2000年国务院18号文颁布以来，北京市集成电路产业进入了快速发展阶段，从2010年到2019年，北京集成电路产业销售收入从不足5亿元增长到1000亿元，排名全国第三，复合年均增长率达7%；其中集成电路设计产业销售收入从不足2亿元增长到600亿元，集成电路设计公司数量从2000年的23家增加到30多家。北京集成电路产业经过十多年的发展，初步形成产业链相对完备的产业格局，并呈现出制造带动、引领、装备材料稳步成长的态势。产业规模和技术水平，一直在全国均占据举足轻重的地位，已成为支撑我国集成电路产业创新发展的重要支撑力量。

深圳市集成电路产业规模位列珠三角地区首位，规划到2023年建成具有国际竞争力的集成电路产业集群，集成电路产业规模达2000亿元，其中设计业销售收入突破1600亿元。深圳市2019年集成电路产业规模将超过1200亿元，其中设计业达1100亿元。

无锡市当前江苏省集成电路产业发展水平最高的城市，规划到2020年底集成电路产业规模达1200亿元。2018年和2019年无锡集成电路产业规模均超过1000亿元。相继随着华虹半导体无锡基地12英寸生产线和宜兴中环领先大硅片项目的顺利投产，1200亿的产业规模目标应该非常轻松达成。

西安市打造集成电路产业新高地。规划在2021年集成电路产业规模达1000亿元。西安华星三星电子存储芯片项目和美光力成封测项目，大大增强了西安集成电路产业中的竞争力。2019年西安集成电路产业规模已达到960亿元，规划目标有望提前完成。

成都市要跻身国内集成电路设计第一方阵，打造中国“芯”高地。规划到2035年集成电路产业规模3400亿元。成都新区正以产业生态圈建设为核心，积极从全球吸引产业链资源，参与全球电子信息产业分工，融入全球电子信息产业链高端和价值链核心，助力成都建设中国电子信息产业核心城市和全球电子信息产业部分领域的中心城市、领军城市。

武汉市被列为国内集成电路产业聚集区，打造世界级半导体产业基地。规划到2020年光谷集成电路产业规模达800

亿。武汉目前有长江存储、武汉新芯等一批制造项目。

合肥市打造中国IC之都。计划到2020年集成电路产业规模达500亿，其中设计业100亿，制造业300亿，封测60亿，设备材料40亿。随着晶合集成、长鑫集成的7纳米以及强势引进的一批设计、材料企业，加上宏实自动化、易芯半导体、大华半导体、芯微电子等一批本土企业，合肥已逐步形成了集成电路设计、制造、封测、设备材料等全产业链，并带动其他高科技产业取得了良好的发展态势。

南京市打造集成电路产业地标。从南京市经信委发布的《关于打造集成电路产业地标的实施方案》中可以获悉，到2025年，全市集成电路产业综合销售收入力争达到1500亿元，进入国内第一方阵，在5G通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现全省第一、全国前三、国际知名。为此南京市明确提出了将设立总投资200亿美元的南京市集成电路产业投资基金，支持集成电路产业垂直整合及并购重组，加大高端人才引进培育力度等。在南京市提出到2025年1500亿元的目标后，让人无语的是江北新区提出到2025年，集成电路产业突破3000亿元。虽然南京近年来加大集成电路项目的引进，但目标的完成恐怕有相当的难度。

苏州市持续大力推动第三代半导体产业发展，通过近十年的培育，目前已汇聚了全国氮化镓材料生长及氮化镓器件产业链80%的国家重点人才计划，确立了第三代半导体产业的“国家队地位”。目前苏州市积极布局第三代半导体中下游环节，引进了英诺赛科、华纳半导体、能讯高能、能华半导体等一批企业，率先构建氮化镓产业完整生态链，并将技术产业化。

来源：芯思想

海关总署：今年前5月我国集成电路进口8794.3亿元

6月7日，海关总署发布统计数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值11.54万亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅和前4个月持平。其中，出口6.2万亿元，下降4.7%；进口5.34万亿元，下降5.2%；贸易顺差6998.12亿元，减少1.2%。按美元计价，前5个月，我国进出口总值1465.7亿美元，下降8%，其中，出口8849.9亿美元，下降7.7%；进口7636.3亿美元，下降8.2%；贸易顺差1213.6亿美元，减少4.5%。

5月份，我国外贸进出口2.47万亿元，同比下降4.9%；其中，出口1.46万亿元，增长1.4%；进口1.01万亿元，下降12.7%；贸易顺差4427.5亿元，增3000.6亿。按美元计价，5月份我国外贸进出口3507亿美元，下降9.3%；其中，出口2068.1亿美元，下降3.3%；进口1438.9亿美元，下降16.7%；贸易顺差629.3亿美元，增加52.9%。

5月出口同比超预期，主要由两方面原因：一是防疫物资出口增速非常快，对5月出口贡献了约9%，这是中国5月出口能维持正增长的关键因素；二是与其他国家相比，剔除防疫物资之后出口增速仍然高，且好于市场普遍预期，表明中国复工复产生产良好，对其他国家生产起到了一定的替代作用。中国占全球出口份额被动增加。

目前海外疫情未得到完全控制，外贸恢复程度较低，4-5月的中采PMI新订单订单仍徘徊在40以下的低位，短期出口可能偏弱。但5月以来欧美主要国家陆续分批放松封禁措施，生产生活逐步重启，加上人民币近期贬值对冲部分压力，预计下半年出口或逐渐恢复。

按照人民币计价，今年前五个月，机电产品进口2.36万亿元，下降0.9%；集成电路进口2011.5亿元，增加27.3%，价值8794.3亿元，增长14.5%；汽车（含底盘）27.8万辆，减少36.9%，价值928.8亿元，下降31.3%。

对东盟进出口增长，对欧盟、美国和日本进出口下降，东盟为我国第一贸易伙伴，欧盟排名第二，美国排名第三，日本排名第四。

来源：人民网-财经频道

IC Insights：中国芯片任重道远



据IC Insights报告披露，如图1所示，在2019年，中国的IC产量占其1.250亿美元IC市场的15.7%，仅略高于2014年的15.1%。IC Insights预测，这一份额将在2024年将增长6.0个百分点，达到20.7%（平均每年一个百分点）。

在中国集成电路市场和中国本土的集成电路生产之间应该有一个非常明显的区别。正如IC Insights经常指出的那样，尽管自2005年以来中国一直是最大的IC消费市场，但这并不一定意味着中国国内IC产量的大幅度增长将立即或随之而来。

去年在中国制造的价值196亿美元的IC中，总部位于中国的外国公司仅生产了76亿美元（38.7%），仅占中国1.246亿美元IC市场的6.1%。台积电、SK海力士、三星、英特尔和其他在中国设有IC晶圆厂的外国公司生产了其产品的。

IC Insights估计，在中国公司生产的76亿美元IC中，约18亿美元来自IDM，58亿美元来自SMC等代工工厂。

如果如IC Insights预测的那样，到2024年，中国制造的IC总产量将增加到430亿美元，那么中国的IC产量仍仅占预测的2024年全球IC市场总额5,075亿美元约8.5%。即便在一般中国代工生产商的IC销售都大幅增加之后，到2024年，中国的IC产量仍可能仅占全球IC市场的约10%。

据IC Insights预计，中国的IC生产在2019-2024年期间将实现17%的强劲复合年增长率。但是，考虑到去年中国IC产量仅为196亿美元，这种增长是从相对较小的基数开始的。在2019年，SK Hynix、三星、英特尔和台积电是在中国具有重要IC生产能力的少数外国IC制造商。

即使中国初创公司YMTC和CXMT正在建立新的IC生

产，但IC Insights仍认为，外国公司将成为未来中国IC产能的重要贡献者。因此，IC Insights预测，到2024年，中国至少有50%的IC产量将来自外国公司。例如SK Hynix、三星、英特尔、台积电、联电和力晶等在中国设有工厂的企业。

随着中美之间的关税和贸易紧张局势，中国各地的政府官员和公司代表决心加快IC建设，积极发展中国的国内IC业务，以减少对目前供应的关键IC组件的依赖于总部位于美国和其他地区的企业。

特别是在存储IC市场，中国正在大力发展

IC Insights表示，中国第一家本地DRAM供应商鑫存半导体技术有限公司（CXMT）在19年第四季度才开始限量生产其第一批DRAM产品。该公司拥有数千名员工，每年的资本支出预算约为数十亿美元。相比之下，美光（Micron）和SK海力士（SK Hynix）分别拥有30,000多名员工，三星的内存部门估计有40,000多名。此外，在2019年，三星、SK海力士和美光的资本支出总额为近四百亿美元，这就是投入差距。

尽管中国继续在其内存制造基础设施上进行大量投资，并从一开始就重视了产品的合规化设计，避免专利纠纷，但IC Insights仍然对国内的存储产业能否在未来十年内发展一个具有竞争优势的本土产业保留态度的。

IC Insights强调，关于中国IC需求的自给自足讨论，许多观察家忽略了一个主要问题，那就是他们缺乏本土的非内存IC技术。他们表示，中国没有主要的模拟、混合信号、服务器MPU、MCU或专用逻辑IC制造商。而这些IC产品细分市场占了去年中国IC市场的一半以上。这些市场由拥有数十年经验和数千名员工的根深蒂固的外国IC生产商所主导。

尽管每个人都专注于中国内存市场的发展，但在非内存IC领域自力更生，对中国来说是一个更加困难的问题。IC Insights认为，中国公司要在非内存IC产品领域中获得竞争力需要数十年的时间。

目前，中国在未来的集成电路产能力方面勇敢面对，但是，鉴于当今中国IC生产技术的起步很小且尚未开发，并且购买先进的半导体制造设备的难度越来越大，IC Insights认为，中国要实现芯片（内存和非内存）自给自足的目标在未来五年甚至未来十年内基本不可能取得重大进展。

来源：半导体行业观察

2020年“北斗”导航系统全面建成

央视新闻客户端消息，中国卫星导航定位协会昨天5月18日发布《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。

2019年卫星导航与位置服务产值近3450亿元。数据显示，2019年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到近3450亿元，较2018年增长14.4%。

白皮书显示，其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元，在总产值中占比为33.8%。特别是随着“北斗+”和“+北斗”应用的深入推进，由卫星导航衍生带动形成的关联产业继续保持较高速增长，达到2284亿元。

中国卫星导航定位协会会长于贤成：虽然受到多种因素的影响，产业增长速度有所放缓，但这已经是连续第九年保持两位数的增长了，还是显示了这个产业的勃勃生机与活力。

随着北斗全球系统建设和产业发展的快速推进，我国卫星导航专利年度申请量持续增长，尤其是最近3-4年专利申请势头强劲。最新数据显示，截止至2019年，专利累计申请量已达到74897件，保持全球第一位。预计卫星导航技术专利申请还将继续保持快速增长态势。

中国卫星导航定位协会会长于贤成：2020年是北斗导航系统全面建成之年，也将成为我国卫星导航产业新一轮发展提供重大助力。这些都推动我国卫星导航产业的健康快速发展，推动北斗更加广泛深入地应用于社会生产生活的各个领域。

北斗导航系统应用领域更加广泛。白皮书显示，在大众应用领域，北斗在电子商务、智能手机和智能穿戴设备等领域应用更加广泛，卫星导航与位置服务的发展正深刻改变着人们的生活方式。

据统计2019年，国内智能手机市场总体出货量3.89亿部。目前，国内外主流芯片厂商已推出兼容北斗的通用一体化芯片，智能手机已成为卫星导航系统最主要的应用领域之一。截至2019年第三季度，在中国市场申请入网的手机有400余款具有定位功能，其中支持北斗定位的近300款。

中国卫星导航定位协会会长于贤成：近几年，北斗制



新应用已经融合到许多产业的转型升级之中，在通信、交通、物流、互联网服务等领域，不少企业创新应用北斗，开拓了不少新的业务。

与此同时，2019年，我国发布了北斗高精度可穿戴设备解决方案，该方案将大幅提升可穿戴设备的定位精度和定位可靠性，实现厘米级定位，可广泛应用于高精度儿童手表、老人手环、对讲机、手机等设备中。随着5G的商用，一些新型可穿戴设备的发展将有望形成未来新兴市场。

中国卫星导航定位协会秘书长张全德：北斗提供了时间和位置，人们生活离不开的时间位置，它的属性它是离不开的。那么就不管智能化怎么发展，首先它需要时间和位置，那么北斗刚好提供时间位置。

随着我国高速铁路、轨道交通等智能化升级改造，以及国内外工程施工领域卫星导航定位技术的创新应用发展，北斗在智慧铁路应用、智慧施工应用等方面也正在形成新兴市场，前景十分广阔。

北斗将面向全球用户提供7大服务。今年6月份，我国还将发射最后一颗北斗三号卫星。根据计划，到2020年系统全面建成之际，北斗将面向全球用户提供7大服务。

在中国及周边地区，所提供的星基增强、地基增强、精密单点定位等服务将为北斗高精度、正在产业化应用奠定坚实基础。从全球范围来讲，北斗三号系统除提供更优的定位、导航和授时服务外，也可以提供全球短报文服务和全球搜救服务。

来源：央视新闻客户端

比亚迪IGBT项目开工，规划25万片八英寸产能

总投资10亿元人民币的长沙比亚迪半导体新能源汽车核心技术研发及产业化项目28日在长沙开工。该项目主要围绕新能源汽车核心技术研发及产业化应用。通过购置高精度光刻机、氧化扩散炉、金属溅射机、减薄机、自动薄片研磨机等核心生产设备，建设年产25万片8英寸新能源汽车电子芯片生产线，解决新能源汽车电子核心功率器件“卡脖子”问题，实现核心部件的国产化。

“将建成国内技术工艺领先的新能源汽车功率模块晶圆生产线，达产后可满足年装车50万辆新能源汽车的产能需求。”比亚迪集团湖南负责人、长沙公司党委书记周晓宇介绍。项目中的IGBT（“绝缘栅双极型晶体管”）产品，其芯片与动力电池电芯并称为电动车的“双芯”，是影响电动车性能的关键技术。成本占整车成本的5%左右。

“对于电动车而言，IGBT直接控制驱动系统，交流电的转换，决定了车辆的扭矩和最大输出功率等，得益于在IGBT等核心技术领域的强大实力，比亚迪电动车的超凡性能得以落地并具备持续迭代升级的能力。”周晓宇说。

作为中国首家自主研发、生产车用IGBT的企业，比亚迪掌握了IGBT全产业链核心技术，打破了国际巨头垄断，成长为全球最大的车规级IGBT厂商。从2009年到2020年历经五代升级，比亚迪IGBT芯片已伴随比亚迪电动车，遍及全球50多个国家和地区、300多个城市。

来源：中国新闻网

国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工

6月20日上午，国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工。省委书记、省人大常委会主任应勇宣布项目开工。省委副书记、省长王忠林致辞。

国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设30 NAND闪存芯片工厂。项目一期于2016年底开工建设，进展顺利，32层、64层存储芯片产品已实现稳定量产，并成功研制出全球首款128层3D闪存芯片。

王忠林代表省委、省政府对项目开工表示祝贺，对长期以来关心支持湖北发展的国家部委和社会各界表示衷心感谢。他说，国家存储器基地项目二期开工，是落实中央支持湖北一批子政策的具体行动，也是强化湖北后发优势重大项目支撑的有力举措，必将加快形成湖北创新发展的“产业航母”，为拓展壮大“光芯屏端网”产业链注入强劲动力。

紫光集团、长江存储董事长赵伟国介绍了项目有关情况。他说，国家存储器基地项目一期开工建设以来，从一片荒芜之地变成了一座世界领先的存储芯片工厂，实现了技术水平从跟跑到并跑跨越。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。我们要增强责任感、紧迫感，知难而进、迎难而上，为集成电路产业发展、为湖北经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

省领导黄楚平、王志林、曹广平，武汉市市长周先旺，紫光集团联席总裁、长江存储执行董事长刁石京等参加活动。王忠林主持开工活动。曹广平宣读了国家有关部委的书面致辞。

来源：武汉发布

关于组织开展2020年度陕西省高新技术企业申报工作的通知

各设区市、杨凌示范区、韩城市科技局，各高新区管委会，各有关企业：

一、申报条件

申报高新技术企业须同时满足以下条件：

（一）企业申请认定时须在陕西境内注册成立一年以上，且财务核算健全，无失信和“黑名单”等不良记录；
（二）企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权；

（三）对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》（见附件1）规定的范围；

（四）企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%；

（五）企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算，下同）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求：1. 最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%；

（六）近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%；

（七）企业创新能力评价达到70分以上；

（八）企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

二、申报方式

（一）常年受理。从2020年6月30日起，陕西省高新技术企业申报常年受理，企业登录“陕西省高新技术企业申报服务系统”（http://kj.shaanxi.gov.cn/kjgz/zlzt/gqd/184881.html，以下简称“申报系统”），注册并填写高新技术企业认定申请书。

2020年6月30日前已提交高新技术企业申请书的，无须重复填报。由省高企认定办将已提交的申请书统一导入“申报系统”。

（二）在线申报。为减轻企业申报负担，申请高新技术企业认定、评审、综合审核、报备和奖励补助全流程在线进行，不用报送纸质材料。申报企业根据系统提示和流程，在线填写提交高企申报所需各类材料。

（三）网络评审。为提高效率，当申报系统受理的推荐企业达到一定数量后，省高企认定办将适时邀请专家，采用集中评审方式进行评审，无需企业到场答辩。

（四）系统管理。各地科技局、国家和省高新区管委会科技部门负责本辖区的企业申报工作，在线做好申报资料审核、推荐审核。企业申报书不再退回和修改，可在系统查询申报进度和状态。省高企认定办成员单位结合专家评审意见在线对企业进行综合审查。

通过综合审核的企业名单，将在陕西省科技厅网站“通知公告”和“高企认定”专栏公示，公示10个工作日。公示无异议，或异议核除企业，按规定办理认定报备手续。

三、申报材料

企业登录“申报系统”填写和上传高企申报材料。证书类的上传原件扫描件，非证书类的上传盖章扫描件。企业要确保申报材料填写的内容和上传的资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息。

陕西省高新技术企业认定管理领导小组办公室
2020年6月29日



2020世界半导体大会即将在南京召开

随着新基建科技领域迅速崛起，新一代移动通信，人工智能、大数据中心、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等领域为集成电路产业和市场发展带来空前机遇。生物芯片、量子通信芯片等超越摩尔技术也展露头角，为半导体技术带来革命性的挑战。同时，在经济增速放缓、全球半导体产品应用端需求下降等利空因素驱使下，半导体行业进入周期性低谷。在此背景下，“2020世界半导体大会（World Semiconductor Conference & Expo 2020）”将于2020年8月26日-28日在南京国际博览中心举办。

本次大会由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、江苏省工业和信息化厅、南京市江北新区主办，由赛迪顾问股份有限公司、江苏省半导体行业协会、南京市江北新区产业技术研创园及南京润展国际展览有限公司承办。此外，大会得到了美国半导体行业协会(SIA)、欧洲半导体行业协会(ESIA)、日本电子信息技术产业协会(JEITA)、韩国半导体行业协会(KSIA)、和SEMI协会的鼎力支持。

大会将以“开放合作，世界同‘芯’”为主题，广邀国内外著名半导体产业、学术、科研、投资、服务、以及新闻界专家及代表，立足南京，放眼世界，为促进半导体产业快速、全面发展提供国际性合作交流平台。本次活动多样，采用“2+4+4+2+N+1”的全新模式，将联合举办高峰论坛、创新峰会两大主论坛，国际第三代半导体产业发展高峰论坛、首届全球传感器与物联网产业创新峰会等4场核心论坛，4场专场发布，2场走进活动，以及多场热点论坛/活动。在各个论坛和专场活动上，政府机构相关负责人、相关领域的院士专家学者、行业领军企业代表将通过主题演讲、成果汇报、院士座谈、专家讲坛、企业家高峰对话、境外嘉宾专题发言等多种形式，围绕论坛主题展开深入专业探讨，紧扣前沿热点，激发思想火花，为中国集成电路产业建言献策、添砖加瓦。本次大会同期举办大型专业展会，目前已有台积电、紫光、ARM、华天等逾百家龙头企业报名参展，将为参会观众展示半导体行业最先进的技术、最高端的产品。

本次大会将共同探讨全球半导体产业前沿趋势与发展大势，为参会观众呈现一场半导体行业的全景盛宴。大会的胜利召开将搭建好中国与世界集成电路互通的国际平台，有效加强半导体产业全球化协作，促进我国半导体产业链协调发展，推动半导体行业健康发展。

详情请识别二维码关注：



来源：中国半导体行业协会